

2018年5月28日

各 位

## JPCA Show 2018に出展

三井金属（代表取締役社長：西田計治）は、2018年6月6日（水）～6月8日（金）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されるJPCA Show 2018「第48回 国際電子回路産業展」に下記の通り出展いたします。

パッケージ基板やスマートフォン用マザーボード（HDI プリント基板）に使用されているキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」、ガラスキャリア付き微細回路形成用材料「HRDP®」をはじめ、機能粉、Cu インクなど、電子回路産業の進化を支える各種製品の展示とプレゼンテーションをいたします。

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、何とぞご光来賜りたくご案内申し上げます。

### 記

展示会名	JPCA Show 2018 「第48回 国際電子回路産業展」
開催期間	2018年6月6日（水）～8日（金）10:00～17:00
開催場所	東京ビッグサイト（東京都江東区）
出展ブース番号	第7ホール 7B-34
出展内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・電解銅箔（MicroThin™、FaradFlex® など）</li><li>・各種機能粉（金属粉、酸化物粉、レアメタル・レアアース粉末）</li><li>・スパッタリングターゲット材</li><li>・開発品（銅インク、蛍光体、脱酸素材）</li><li>・微細回路形成用材料 HRDP®</li></ul>
展示会オフィシャルサイト	<a href="http://www.jpca-show.com">http://www.jpca-show.com</a>

以 上

### 【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール [PR@mitsui-kinzoku.co.jp](mailto:PR@mitsui-kinzoku.co.jp)

【ご参考】

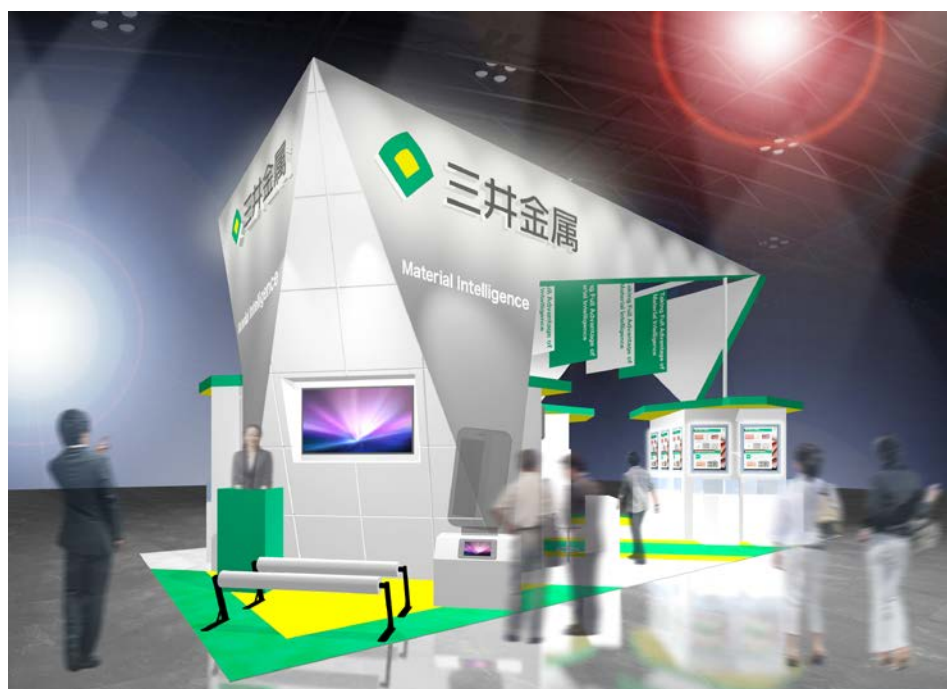
製品プレゼンテーション（期間中毎日 午前と午後の2回）

午前の部

- 11:00 ～ 銅箔事業部（電解銅箔）
- 11:15 ～ HRDP<sup>®</sup>
- 11:30 ～ 機能粉事業部（高機能性粉末）
- 11:45 ～ 焼結型銅インク

午後の部

- 14:00 ～ 銅箔事業部（電解銅箔）
- 14:15 ～ HRDP<sup>®</sup>
- 14:30 ～ 機能粉事業部（高機能性粉末）
- 14:45 ～ 焼結型銅インク



展示ブースのイメージ